



ANLAGEN- UND MASCHINENBAU

ANWENDUNGSBEISPIEL

Gehäuse-Lösung für universellen Einsatz

In enger Zusammenarbeit mit seinem Kunden, einem Hersteller von Komponenten und Systemen der Industrie-elektronik, entwickelte HEITEC eine universell einsetzbare Gehäuse- und Systemlösung, die in unterschiedlichen Industriezweigen eingesetzt werden kann und ab sofort die neue Standardplattform des Kunden darstellt. Durch ihr modulares Design kann sie flexibel an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden und ermöglicht z.B. auch eine einfache built-to-order-Konfiguration.

Um ein möglichst wandlungsfähiges System bereitzustellen zu können, entschied man sich für die Verwendung der Tisch- und Systemgehäusefamilie HeiPac Vario Modul mit einer Breite von 42TE in Kombination mit spezifischen Sonderkomponenten. Um dem Corporate Design des Kunden zu entsprechen, ist das Deck- und Bodenblech im gewünschten Farbton lackiert. Ausgestattet mit Aufstellfüßen ist das System vor allem für den Betrieb im Labor und in der Forschung/Entwicklung gedacht. Die Aufstellfüße können aber auch abgenommen werden. Das System ist jederzeit an die möglichen Verwendungszwecke anpassbar. So stehen eine Vielzahl von 19"-Halteflanschen, Haltegriffen für die Front, Tragegriffe für den Deckel oder z.B. auch Aufstell-/Tragebügel zur Auswahl.

Das gesamte System ist als EMV-Variante konzipiert, damit bei möglichen Zulassungstests keine Überraschungen

zu erwarten sind. Dies unterstreicht auch das integrierte 230V-Eingangsterminal mit zusätzlicher Sicherung und EMV-Filter. Damit können unterschiedliche – für den jeweiligen Einsatzzweck passende – Stromversorgungen in das System eingebaut und angeschlossen werden.

Das modulare 19-Zoll-Gehäusekonzept ermöglicht die Integration von Backplanes verschiedenster Standards durch den Kunden. Die gängigen Standards sind z.B. VPX, CompactPCI®, CompactPCI®-Serial aber auch der schon länger existierende VMEbus™. Durch die Gehäuse-tiefe von über 280 mm ist auch die Integration von Rear-I/O-Baugruppen (werden auf der Rückseite eingeschoben) jederzeit möglich.

Durch die vielfältigen Anwendungsgebiete können die Innenausbauten und damit auch die Wärmeentwicklung im System stark variieren. Um die Flexibilität aufrecht zu erhalten, ist der Baugruppenträger mit zwei 80 mm Lüftern ausgestattet. Diese sorgen für eine Belüftung in vertikaler Richtung, sind für einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C zugelassen und lassen sich durch zusätzlich vorhandene Regel- und Überwachungsanschlüsse problemlos an das Temperaturmanagement des späteren Systems anbinden.

Universelle Gehäuselösung



Frontale Ansicht des Standard-Gehäuses inklusive der vom Kunden nachträglich montierten Backplane und Netzteil



Rückansicht mit vorbereitetem Netzeingang und zusätzlichem Raum für Rear-I/O-Baugruppen

Technische Kurzbeschreibung

- › Tisch- und Systemgehäuse HeiPac Vario Modul in Kombination mit kundenspezifischen Komponenten
- › Kompatibel mit Backplanes verschiedener Standards
- › T x B x H: 283 mm x 42TE x 4HE
- › 2x 80 mm Lüfter mit PWM- und Tacho-Anschlüssen (Temperaturbereich -20°C bis +70°C)
- › Verschiedene Griffvarianten wählbar
- › Vorbereitet für Rear-I/O
- › EMV-Variante

Kundenvorteile

- › Variable und kompakte Gehäuse-Lösung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- › Vorbereitet für integrierbares Belüftungskonzept
- › Vielfältige Montage- und Transportmöglichkeiten
- › Preisgünstige Systemlösung

HEITEC AG

Dr.-Otto-Leich-Str. 16
90542 Eckental

Telefon: +49 9126 2934 0

Fax: +49 9126 2934 199

E-Mail: elektronik@heitec.de

Internet: www.heitec-eps.de